

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/papier-scierny-na-dysk-125mm-p100silicon-carbide-geko-g78424-p-19999.html>

Papier ścierny na dysk 125mm P100 "SILICON CARBIDE" GEKO G78424

Cena brutto	12,30 zł
Cena netto	10,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G78424
Kod producenta	G78424
Kod EAN	5901477118913
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Papier ścierny na dysk 125mm P100 Silicon Carbide GEKO G78424

Wodoodporny papier ścierny z ziarnami węgla krzemu, przeznaczony do montażu na dyskach szlifierskich o średnicy 125 mm. Gradacja P100 zapewnia równowagę między wydajnością szlifowania a gładkością uzyskiwanej powierzchni.

Srednica 125 mm

Gradacja P100

Materiał ścierny Silicon Carbide

Właściwości Wodoodporny

Charakterystyka produktu

Ziarna węgla krzemu (SiC)

Silicon Carbide charakteryzuje się większą twardością i ostrością niż tlenek glinu. Dzięki temu skutecznie szlifuje twarde i kruche materiały, takie jak kamień, szkło, ceramika czy lakiery samochodowe. Ziarna łamią się podczas pracy, odstawiając świeże krawędzie tnące.

Gradacja P100 (155 µm)

Wielkość ziarna około 155 mikrometrów. Stosowana do usuwania nierówności, rys oraz przygotowania powierzchni przed wykończeniem. Pozostawia widoczne ślady szlifowania, które należy usunąć papierami drobniejszymi (P150-P240).

Konstrukcja wodoodporna

Specjalne spoiwo i podłoże odporne na wilgoć umożliwiają szlifowanie na mokro. Woda odprowadza ciepło, zmniejsza zapylenie i zapobiega zatykaniu się ziaren przez usuwane cząstki materiału. Przedłuża to żywotność papieru i poprawia jakość szlifowania.

Format na dysk 125 mm

Przygotowany do montażu na tarczach szlifierskich z systemem rzepowym (velcro) o średnicy 125 mm. Sprawdź, czy dysz szlifierski posiada otwory odprowadzające pył - papier musi być kompatybilny z systemem odsysania, jeśli jest on używany.

Specyfikacja techniczna

Model	G78424
Średnica	125 mm
Gradacja	P100 (155 µm)
Materiał ścierny	Węglik krzemu (Silicon Carbide)
Wodoodporność	Tak
Typ mocowania	System rzepowy (velcro)
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Szlifowanie kamienia naturalnego i sztucznego
- Obróbka szkła i wyrobów ceramicznych
- Usuwanie zacieków i rys na lakierze samochodowym
- Przygotowanie powierzchni karoserii przed polerowaniem
- Matowanie powierzchni szklanych
- Wyrównywanie nierówności na twardych materiałach
- Szlifowanie zapraw i mas szpachlowych
- Obróbka kompozytów i tworzyw sztucznych

Szlifowanie na mokro vs. na sucho

Szlifowanie na mokro zmniejsza temperaturę w strefie obróbki, zapobiega pęknięciom materiału i przedłuża żywotność papieru. Przy szlifowaniu lakierów wodnych zapobiega zatykaniu się ziaren. Szlifowanie na sucho jest szybsze, ale generuje więcej pyłu i wymaga częstszej wymiany papieru.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy papier jest prawidłowo zamocowany na dysku szlifierskim - luźne mocowanie może prowadzić do nierównomiernego szlifowania. Podczas pracy nie wywieraj nadmiernego nacisku - ciężar szlifierki zazwyczaj wystarcza. Zbyt duży nacisk skraca żywotność papieru i może uszkodzić obrabiany materiał.

Przy szlifowaniu na mokro stosuj niewielką ilość wody - materiał powinien być wilgotny, ale nie zalany. Regularnie płucz papier, aby usunąć nagromadzone cząstki. Po zakończeniu pracy osusz papier, jeśli planujesz jego ponowne użycie.

Przechowuj papiery w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Wilgoć może osłabić spoiwo nawet w papierach wodoodpornych. Wymieniaj papier, gdy zauważysz spadek wydajności szlifowania lub nierównomierne ślady - zużyte ziarna nie zapewniają równomiernej obróbki.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obróbki powierzchni rozważ zakup papierów o różnych gradacjach: P80 do usuwania grubszych nierówności, P150-P240 do wykańczania oraz P400-P800 do polerowania. Dysz szlifierski z regulacją obrotów pozwala dostosować prędkość do rodzaju materiału i stopnia zaawansowania prac.